2026 年 11 月 2 日
東京エレクトロン株式会社
コーポレート企画本部　IR 室

2027 年 3 月期 第 2 四半期 決算説明会 Q&A

■ 質問一覧

Q1　CY2026 および CY2027 の WFE 市場の見通しについて、アプリケーション別の内訳を教えてほしい。

Q2　CY2027 の WFE 市場$210B 以上という見通しは、供給面の制約を考慮したものか、それとも顧客の需要を積み上げたものか？

Q3　CY2027 の WFE 市場見通しが引き上がった背景を教えてほしい。また、仮に CY2027 に WFE 投資が大きく増加した場合、CY2028 に反動減となる可能性はないのか？

Q4　CY2026 の TEL の売上高は CY2025 比 40%程度の成長となり、WFE 市場の成長率（30%前後）を 10pts 程度上回ると思われる。シェア上昇の要素や生産の状況を踏まえ、CY2027 も WFE 市場を上回る成長は可能か？

Q5　FY2027 の製品別の売上見通しについて、塗布現像装置は FY2026 比+50%超、エッチング装置は+25%超という見方だったと思うが、全体的に従来の見通しに変更はあるか？

Q6　FY2027H2 は売上の増加や Q4 からの価格改定効果も見込まれる。こうしたプラス要因がある中で、FY2027H2 の売上総利益率を Q2 と同等の 48%程度と見込む背景は何か？

Q7　売上総利益率 50%について、FY2027Q4 で達成する可能性はあるか？また、FY2028 の早い時期にこの水準を達成し、その後も売上の拡大が続くとすれば、FY2028 通期でも売上総利益率 50%がボトムラインになると考えてよいか？

Q8　米国の競合他社は売上総利益率 55%という目標を示しているが、長期的には同程度の水準を視野に入れているか？

Q9　納期前倒しに伴うサーチャージや部材高騰の価格転嫁は FY2027H2 の業績予想にどの程度織り込まれているのか？また、価格改定が売上総利益の向上に寄与するのは FY2028 からか？

Q10　価格改定について、為替影響による米国競合他社との価格差も踏まえ、今回限りではなく、来期以降も継続すると考えてよいか？

Q11　足元の売上や FY2028 にかけての引き合いに対して、部材調達による制約やボトルネックは発生していないか？また、FY2027H2 の生産キャパシティは確保できているとの説明があったが、売上規模の一段の拡大や、AI 向けの引き合いが現在の見通し以上に強まる可能性も見据えて、TEL の工場およびサプライチェーン全体としての増産対応の考え方を教えてほしい。

Q12　2026 年 10 月 15 日に経済産業省から発表された、日米政府の「戦略的投資イニシアティブ」における半導体製造プロジェクトについて、TEL にとっての事業機会と、本件に伴う義務の有無を教えてほしい。

■ Q&A

Q1 CY2026 および CY2027 の WFE[*1] 市場の見通しについて、アプリケーション別の内訳を教えてほしい。

A1 CY2026 の WFE 市場は約$160B で、ロジック/ファウンドリとメモリの構成比率は約 6：4 と想定している。アプリケーション別では、DRAM が$40B 台後半、NAND が$10B 台半ば、ロジック/ファウンドリが$80B 台後半、ファクトリーオートメーションやウェーハレベルパッケージングなどが約$10B。また、ロジック/ファウンドリにおける先端分野の構成比率は約 30%と見ている。
CY2027 の WFE 市場は$210B 以上で、ロジック/ファウンドリとメモリの構成比率は約 5：5%だが、ロジック/ファウンドリがやや高いと見ている。アプリケーション別では、DRAM が$70B 台前半、NAND が$10B 台後半、ロジック/ファウンドリが約$100B、ファクトリーオートメーションやウェーハレベルパッケージングなどが$10B 台前半。また、ロジック/ファウンドリの先端分野の構成比率は 35%から 40%弱と見ている。

▲Top

Q2 CY2027 の WFE 市場$210B 以上という見通しは、供給面の制約を考慮したものか、それとも顧客の需要を積み上げたものか？

A2 顧客からいただいている設備投資計画を積み上げたもの。足元の強い引き合いを考慮すると、上振れる可能性もある。

▲Top

Q3 CY2027 の WFE 市場見通しが引き上がった背景を教えてほしい。また、仮に CY2027 に WFE 投資が大きく増加した場合、CY2028 に反動減となる可能性はないのか？

A3 半導体需要を牽引するアプリケーションが、従来の PC やスマートフォンなどから、データや AI を中心としたものへと明確に変化しており、半導体の役割が広がっているためと考えている。また、エージェンティック AI やフィジカル AI、新しいデータセンターなど、アプリケーションの拡大に伴う追加の引き合いもいただいている。現時点では、顧客との対話の中で減速を示す話は出ていない。

▲Top

Q4 CY2026 の TEL の売上高は CY2025 比 40%程度の成長となり、WFE 市場の成長率（30%前後）を 10pts 程度上回ると思われる。シェア上昇の要素や生産の状況を踏まえ、CY2027 も WFE 市場を上回る成長は可能か？

A4 当社の主力である塗布・現像装置、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置は、半導体製造に不可欠かつ市場規模の大きい領域であり、WFE 市場の成長と同等以上に伸ばしていけると考えている。特に塗布・現像装置は市場シェア 90%以上ということで、世界中の引き合いを取り込んでおり、WFE 市場を上回る成長を牽引する領域になるとみている。
また、アドバンストパッケージングにおける 3 次元実装領域も CY2027 以降に大きく伸長する見込みであり、成長機会として期待している。プローバについても、テスト工程の増加に伴い、CY2027・CY2028 ともに非常に大きな引き合いをいただいている。これらを踏まえ、WFE 市場をアウトパフォームすることを目指した計画を策定できると考えている。

▲Top

Q5 FY2027 の製品別の売上見通しについて、塗布現像装置は FY2026 比+50%超、エッチング装置は +25%超という見方だったと思うが、全体的に従来の見通しに変更はあるか？

A5 製品別売上成長率は、今回は開示していないが、ほぼすべての装置において想定より増加している。特に当社が 90%以上のシェアを有している塗布現像装置は、設備投資額が大きく拡大している。

▲Top

Q6 FY2027H2 は売上の増加や Q4 からの価格改定効果も見込まれる。こうしたプラス要因がある中で、FY2027H2 の売上総利益率を Q2 と同等の 48%程度と見込む背景は何か？

A6 FY2027H1 の売上総利益率の実績 47.4%に対して、FY2027H2 は約 1pt 上昇の 48.3%を見込む。一部の高利益案件が FY2027H1 に前倒しとなったことに加え、FY2027H2 には増産や納期前倒しへの対応費用を織り込んでいる。

▲Top

Q7 売上総利益率 50%について、FY2027Q4 で達成する可能性はあるか？また、FY2028 の早い時期にこの水準を達成し、その後も売上の拡大が続くとすれば、FY2028 通期でも売上総利益率 50%がボトムラインになると考えてよいか？

A7 FY2027Q4 の売上総利益率 50%については、スタートアップの売上計上が前倒しとなれば達成する可能性はある。一方、顧客のファシリティ工事の進捗にも左右されるため、達成の確度についての言及は控える。FY2028 の業績予想は開示していないため、具体的な数値への言及は控えるが、想定される WFE 市場の成長と期待される収益性向上を踏まえ、売上総利益率のさらなる改善を目指す。

▲Top

Q8 米国の競合他社は売上総利益率 55%という目標を示しているが、長期的には同程度の水準を視野に入れているか？

A8 付加価値の高い製品やサービスを提供する機会は非常に大きく、需要の拡大に伴う効率性の向上やコスト低減も期待できる。当社は、「利益は製品とサービスの価値の大きさを示す尺度」という考えのもと、事業を展開しており、利益率のさらなる改善に取り組んでいく。

▲Top

Q9 納期前倒しに伴うサーチャージや部材高騰の価格転嫁は FY2027H2 の業績予想にどの程度織り込まれているのか？また、価格改定が売上総利益の向上に寄与するのは FY2028 からか？

A9 増産や納期前倒しに伴う費用については顧客の理解を得ており、部材価格高騰に伴う販売価格への転嫁についても順調に進んでいる。FY2027H1 から H2 への約 1 ポイントの改善については、約半分が生産増による効果、残りの約半分が継続して進めている価格改定による効果を見込んでいる。価格改定については本格的に寄与するのは FY2028 からを想定している。

▲Top

Q10 価格改定について、為替影響による米国競合他社との価格差も踏まえ、今回限りではなく、来期以降も継続すると考えてよいか？

A10 価格改定は一度限りではない。インフレや為替変動、海外でのサポートコストなどを背景としたコスト増については、顧客にご理解をいただいたうえで適切に販売価格に反映させていく。
また、技術革新による歩留まり向上や、AI 活用による装置稼働率の向上、新製品やアップグレードなどを通じて顧客への提供価値を高め、適正な価格で販売していく。

▲Top

Q11 足元の売上や FY2028 にかけての引き合いに対して、部材調達による制約やボトルネックは発生していないか？また、FY2027H2 の生産キャパシティは確保できているとの説明があったが、売上規模の一段の拡大や、AI 向けの引き合いが現在の見通し以上に強まる可能性も見据えて、TEL の工場およびサプライチェーン全体としての増産対応の考え方を教えてほしい。

A11 足元の強い引き合いを受け、部材によっては細かなマネジメントが必要な状況にあるが、2026 年末から 2027 年始には FY2028 にかけての調達・出荷の見通しが明確になってくる見込み。
生産キャパシティについては、東北生産・物流センターや自動倉庫の建設、他の工場での生産スペースの確保など、プロアクティブにキャパシティを拡大している。市場規模が最も大きいエッチング装置では、2027 年夏に竣工予定の宮城生産革新センターにより、キャパシティをさらに追加できる。工夫と努力は必要だが、対応は可能と考えている。
サプライチェーンについては、顧客から長期的な需要情報をいち早く提供いただき、サプライヤーに 1～2 年のフォーキャストを共有しながら、調達懸念がある部材を事前に確保し、適切な在庫水準を保つオペレーションを実行する。また、需給がひっ迫しかねないパーツやユニットのリストを作成して適切に対応するとともに、サプライヤーとの強いパートナーシップのもと、必要に応じて当社からのサポートも加えながら需要に応えていく。
さらなる増産に向けては業界全体での改善の取り組みが必要と認識している。

▲Top

Q12 2026 年 10 月 15 日に経済産業省から発表された、日米政府の「戦略的投資イニシアティブ」における半導体製造プロジェクトについて、TEL にとっての事業機会と、本件に伴う義務の有無を教えてほしい。

A12 当社にとっては事業機会であり、投資に伴う義務はないと考えている。

▲Top

*1 WFE: Wafer Fab Equipment

FY2026 は 2025 年 4 月～2026 年 3 月の会計年度を指しています。
FY2027 は 2026 年 4 月～2027 年 3 月の会計年度を指しています。
FY2028 は 2027 年 4 月～2028 年 3 月の会計年度を指しています。
本内容は質疑応答のサマリーです。